

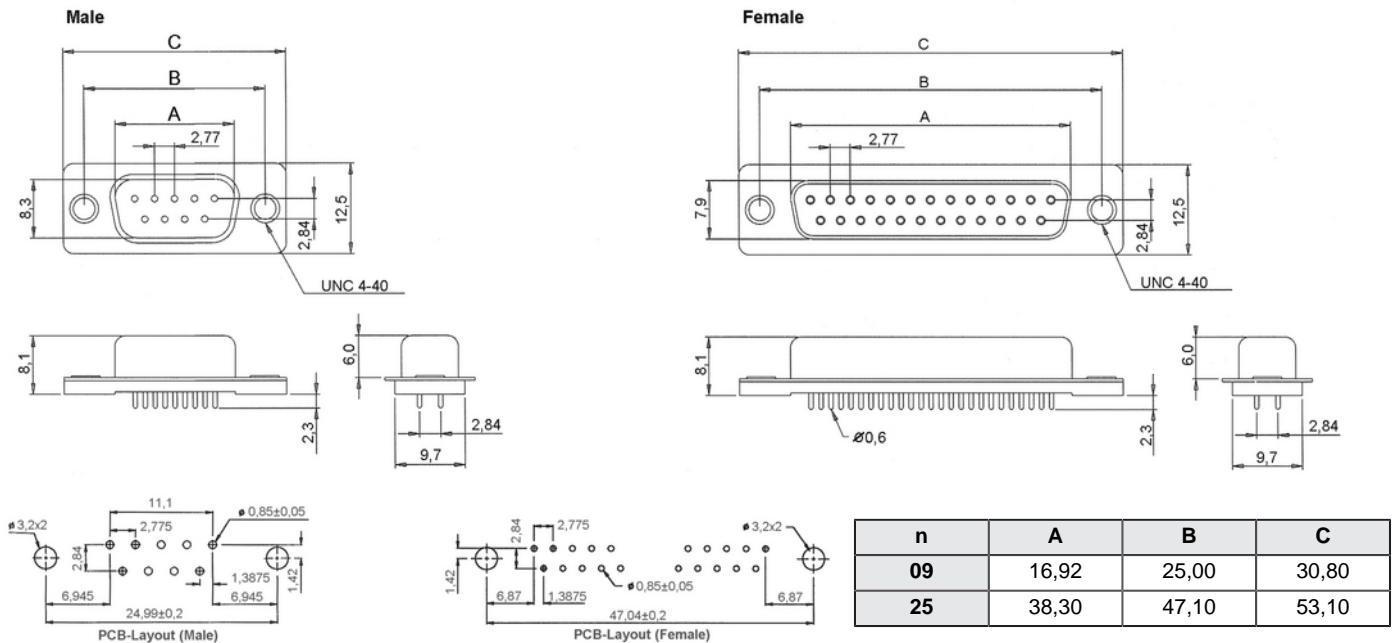
D-SUB Steckverbinder, gerade, Lötstifte - Notebook-Version D-SUB Connectors, Straight, Solder Pins - Notebook Type

Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Stahl vernickelt, verzinkt
Shell	Steel, tin coated over nickel
Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	Gold over nickel
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1kV _{AC}
Test Voltage	1kV _{AC}
Nennstrom	5A
Current Rating	5A
Temperaturbereich	-55°C ... +125°C
Temperature Range	-55°C ... +125°C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	Wave soldering



© W+P PRODUCTS



Series

425

Contacts*

25

09 Für Stift verfügbar
Available for male type
25 Für Buchse verfügbar
Available for female type

Terminal*

2

1 Stift
Male
2 Buchse
Female

Quality*

3

GK 1 >500 Steckzyklen
Quality class 1: 500 cycles min.
GK 2 >200 Steckzyklen
Quality class 2: 200 cycles min.
GK 3 >50 Steckzyklen
Quality class 3: 50 cycles min.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:

